

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2026-005

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2026年1月9日召开了第五届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合公司募集资金投资项目的实际情况及未来业务发展的规划，并经过谨慎的研讨论证，将“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，公开发行可转换公司债券3,390.00万张，每张面值100元，共计募集资金人民币339,000.00万元，本次公开发行可转换公司债券发行承销保荐费及其他发行费用（不含税）共计人民币1,187.59万元，本次公开发行可转换公司债券认购资金总额扣减上述发行费用（不含税）后募集资金净额为人民币337,812.41万元，已于2022年11月18日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7581号）。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	投入进度（%）
1	年产180万片12英寸半导体硅外延片项目	113,000.00	62,263.61	55.10
2	年产600万片6英寸集成电路用硅抛光片项目	125,000.00	124,739.68	99.79

序号	募投项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额	投入进度 (%)
3	补充流动资金	101,000.00	99,990.28	99.00
	合 计	339,000.00	286,993.57	84.66

注：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金累计投入金额 286,993.57 万元，该金额不包含已支付的发行费用 1,187.59 万元。

三、关于募集资金投资项目延期的具体情况

(一) 募集资金投资项目首次延期情况

因受公司所处行业市场景气度偏弱，市场需求下降等因素的影响，为保障公司和中小股东利益、降低募集资金的投资风险，公司实行审慎投资策略，稳步推进募集资金投资项目的实施。公司于2024年4月22日召开了第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，将“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”完成期限延长至 2026 年 5 月。

(二) 募集资金投资项目本次延期情况

公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：

序号	募投项目名称	项目达到预定可使用状态时间	
		调整前	调整后
1	年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目	2026 年 5 月	2027 年 12 月

(三) 募集资金投资项目本次延期原因

“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”自首次延期以来，因半导体硅片行业在一段时期内仍处于下行周期，造成公司已投产的 12 英寸半导体硅外延片产能利用不足，导致公司现有已投产的 12 英寸半导体硅外延片在投产初期已经面临较大的盈利压力，若按照原定建设计划投入将给公司带来较大的业绩风险。因此公司放缓了对“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”所需新建的外延车间厂房的建设进度，对设备的采购节奏进行了阶段性调整，致使公司“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”预计无法按照计划进度完成。

目前“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”所需新建的外延车间厂房已经结顶，正处于厂房装修阶段，预计厂房及生产洁净车间的建设将于 2026 年 8 月份完成。厂房及生产洁净车间建设完成后，公司采购的设备将陆续进行安装、调试，因公司“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”所需的设备为半导体精密设备，部分设备安装、调试所需时间较长。待全部设备安装、调试完成后，产线经过一段时间的协同运行后方能投入生产。综上所述，经

公司判断，“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”距离建成投产仍需一定的时间。经综合分析与审慎评估，在不改变项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模等的情况下，公司决定将“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”完成期限延长至 2027 年 12 月。

自 2025 年第一季度以来，半导体硅片行业景气度开始回升，公司重掺外延片订单充足，出货量同比、环比均有大幅增长，产能利用率取得显著增长，公司 12 英寸重掺系列外延片下游高端功率器件（AI 服务器不间断电源、储能变流器等）需求增长显著。在此情况下，公司自 2025 年下半年以来，结合市场实际需求，已加快了项目建设的进度。后续公司将继续密切关注市场环境变化，及时跟进该等募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，结合公司资金状况、市场供需状况对建设进度进行动态调节，加强募集资金使用的监督管理，以保障项目延期后按期完成。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响及风险提示

公司本次部分募集资金投资项目延期调整是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次延期系公司依据中长期发展战略，实行审慎投资策略，稳步推进募集资金投资项目的实施，维护全体股东的利益，且本次部分募集资金投资项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募投项目“年产 180 万片 12 英寸半导体硅外延片项目”预定达到可使用状态的时间调整延长。公司董事会审计委员会已审议通过该事项，该事项无需提交公司股东会审议。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过。公司本次延期事项履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司

本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2026年1月10日